

Material Composition Declaration



PKG		Total Mass [mg]
JT21S		8,380

Part Name	Weight of parts(mg)	Material Name	CAS No.	Substance	Weight [mg]	Weight [% of part]	Weight [% total]
BASE	6,500	Ceramic + Wiring	1344-28-1	Al ₂ O ₃	4,030	62,000	48,092
			1317-34-6	Mn ₂ O ₃	0,150	2,308	1,790
			7631-86-9	SiO ₂	0,140	2,154	1,671
			1313-27-5	MoO ₃	0,020	0,308	0,239
			1309-48-4	MgO	0,010	0,154	0,119
			7439-98-7	Mo	0,750	11,538	8,950
			7440-02-0	Ni	0,400	6,154	4,773
			7440-48-4	Co	0,170	2,615	2,029
			7440-57-5	Au	0,050	0,769	0,597
			7439-89-6	Fe	0,400	6,154	4,773
			7440-22-4	Ag	0,320	4,923	3,819
7440-50-8	Cu	0,060	0,923	0,716			
LID	1,54	Kovar	7439-89-6	Fe	0,826	53,649	9,859
			7440-02-0	Ni	0,444	28,812	5,295
			7440-48-4	Co	0,260	16,890	3,104
			7440-57-5	Au	0,008	0,532	0,098
			7440-31-5	Sn	0,002	0,117	0,021
BLANK	0,133	Quartz	14808-60-7	SiO ₂	0,133	100,000	1,587
ELECTRODE	0,004	Metal	7440-57-5	Au	0,004	99,500	0,047
			7440-02-0	Ni	0,000	0,500	0,000
BLANK ADHESIVE	0,023	Silicone resin	7440-22-4	Ag	0,018	78,000	0,214
			68083-19-2	Siloxan	0,003	15,000	0,041
			7631-86-9	SiO ₂	0,002	7,000	0,019
Au Ball	0,005	Metal	7440-22-4	Au	0,005	98,900	0,057
			03.05.7440	Pd	0,000	1,100	0,001
IC DIE	0,150	IC DIE	7440-21-3	Si	0,148	98,827	1,769
			7429-90-5	Al ₂ O ₃	0,001	0,420	0,008
			7440-32-6	Ti	0,000	0,247	0,004
			7440-33-7	W	0,001	0,507	0,009
Underfill	0,025	Epoxy resin	55492-52-9	Epoxy	0,006	25,000	0,075
			25068-38-6	Phenol	0,006	25,000	0,075
			7361-86-9	SiO ₂	0,013	50,000	0,149